

AUROMEX[®]

TECHNICAL

INSTRUCTIONS

DATA SHEETS

NIKOMEX GTS-W 低應力鍍半光鍍光澤劑

簡介：

AUROMEX NIKOMEX GTS-W 是一改良低應力鍍半光鍍配方，能在最短時間內獲得理想之柔軟而富光澤性鍍鍍層，同時較其他一般鍍鍍省時，有助於降低金屬鍍的消耗，減低成本。此配方特別適用於電子工業，機械零件、眼鏡及一般裝飾性鍍鍍使用。

配方特性：

- * 鍍層為半光澤性鍍。
- * 鍍層伸延性特強及脆性極低。
- * 覆蓋能力強，厚度分佈平均。
- * 操作簡易，穩定性強。

鍍液的配製及操作條件：

	<u>單位</u>	<u>範圍</u>
硫酸鍍	克 / 公升	300-350
鍍金屬含量	克 / 公升	70-80
氯化鍍	克 / 公升	40-50
硼酸	克 / 公升	40-50
NIKOMEX GTS-W 添加劑	毫升 / 公升	20-40
NIKOMEX NIWA 防孔水	毫升 / 公升	0.5-1.0
pH		4.2-4.8
溫度	°C	50-65
陰極電流密度 (掛鍍)	安培 / 平方分米	1-4
(噴鍍)	安培 / 平方分米	2-8
攪拌		陰極攪拌

P.1

AUROMEX[®]

CHEMICALS CORPORATION

UNIT NO. 2, 4/F., INTERNATIONAL PLAZA, 20 SHEUNG YUET ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, H.K.

TEL: 2796 7238

FAX: 852-2796 7117

鍍液維護：

- 1) 鍍液的主要成份如硫酸鎳，氯化鎳及硼酸等應保持在適當範圍內，光澤劑的補充方法可參巧以下補充量：
NIKOMEX GTS-W 添加劑：500-1000 毫升 / 千安培小時
- 2) 保持鍍液 pH 在 4.2-4.8 之間，如 pH 值過高或過低，可用 25% 稀硫酸或碳酸鎳調整。
- 3) 操作時應盡量防止帶入金屬或有機雜質污染鍍液，如鍍液受污染，有機雜質可用活性炭處理，金屬雜質可用低電處理或加入 0.1-0.5 cc / 公升 **NIKOMEX MPLEX** 除雜水。